



非硅导热凝胶 TPU2000

Silicone Free Thermal Conductive Gel TPU2000

产品概述

TPU2000 是无硅氧烷挥发型双组份导热凝胶材料，产品按 1:1 比例混合后具有良好的触变性和低粘度，适用于硅敏感终端应用，可有效减少硅污染。在许多特殊应用中，硅胶的低分子硅氧挥发物会造成光学与电学性质故障的，同时本产品有着比传统非硅材料更低的硬度，可以提供更高的变形量与更高的导热性能。可典型应用于硬盘及光学精密设备等要求零硅污染的产品中。

固化前产品特性

外观	黄色粘稠液体
A 组分粘度 (Brookfield CP52, mPa.s(cP))	550000
B 组分粘度 (Brookfield CP52, mPa.s(cP))	580000
密度(ASTM D792,g/cm ³)	2.8
混合比例	1:1
挤出速率 (2mm 针头 90psi, g/min)	>20
储存条件 (<25°C, 6 months)	3

产品固化条件

操作时间@25°C, min	60/300
固化时间@25°C, h	5/24
加速时间@100°C, min	30/60

固化后产品特性

项目	测试方法	单位	数值
导热系数	ASTM D5470	W/mK	2.0
热阻 (@0.5mm)	ASTM D5470	°Cin ² /W	0.37
表面电阻 (shore 00)	ASTM D257	Ohm-meter	10 ¹³
击穿电压	ASTM D2240	--	70
介电常数	ASTM D149	KV/mm	>10
抗拉强度	ASTM D150	25 oC, 1 kHz	7
伸长率	ASTM D149	psi	15
硅氧烷挥发量	ASTM D149	%	40
阻燃等级	GC-FID	D4~D20	0
操作温度	UL94	--	V-0
	--	oC	-40-125

产品包装及货期

小包装	50CC、400CC、600CC 双液针管
大包装	20L 桶装
最小包装量 (MPQ)	50CC
最小订单量 (MOQ)	50CC
交货期 (L/T)	10-15 个工作日
常温快速固化产品	可定制

